杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司于 2004 年 12 月 6 日以电子邮件方式向本公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知,该董事会于 2004 年 1 2 月 15 日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》。

杭州士兰集成电路有限公司(以下简称"士兰集成"),注册资本为16000万元,经营范围为:集成电路,半导体分立器件的制造和销售;自产产品及技术的出口业务;经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。截至2004年9月30日,该公司总资产为457,120,572.68元,负债293,151,732.98元,净资产163,968,839.70元。2004年前三季度主营业务收入为78,686,133.85元,净利润15,813,628.60元。

士兰集成的芯片生产线技改项目是公司募集资金的投向。公司按照该项目实施进程,计划分期拨付募集资金共24960万元人民币给士兰集成,作为芯片生产线技改项目的建设资金。为了进一步规范运作,增强士兰集成的发展实力,公司已向士兰集成增加投资9600万元人民币。根据计划进度,本次公司拟向士兰集成增加投资5850万元人民币,资金来源为公司已向该公司拨付的募集资金。本次增资完成后,公司累计向士兰集成增资15450万元人民币,以往来款的形式拨付募集资金6400万元人民币。同时,公司的参股公司杭州友旺电子有限公司本次对士兰集成增资150万元人民币,累计向士兰集成投资550万元人民币。

本次士兰集成增资完成后,其注册资本由 16000 万元人民币变更为 22000 万元人民币,本公司持有其 97.50%的股权比例没有发生变化。 特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2004年12月15日